

銅張積層板

『3層タイプ』

使用例

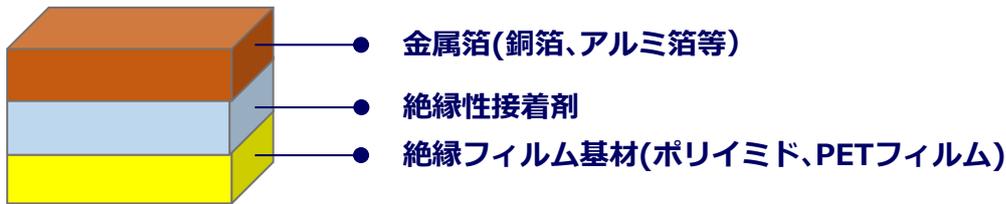
- ・携帯電話、タブレット等のモバイル端末
- ・ハードディスクドライブ ・DSC
- ・LED用基板 ・車載用途



特徴

- ・ポリイミド等の基材フィルムに、自社で設計した接着剤をコーティングし、銅箔をラミネートした3層タイプ銅張積層板です。
- ・用途に応じたご希望の特性、基材を用いた製品を設計、開発する事が可能です。

構成



※同構成での両面板の対応も可能です。

特性

		条件	単位	LC	LE(P)	LCB(黒)	L60R(白)	LSPGS
特徴				汎用	高Tg	黒	白	透明
構成		-	-					
180°引き はがし強さ	MD	A	N/cm	11.0	7.5	9.0	10.0	8.0
寸法変化率	E-0.5/ 150	MD	%	-0.08	-0.15	-0.15	-0.10	*-0.18
		TD		+0.08	+0.02	+0.08	-0.05	*0.06
はんだ耐熱性			℃	300	300	300	300	190
接着剤 Tg		-	℃	42	143	42	50	30
接着剤 弾性率		A	GPa	0.3	4.0	0.4	1.5	0.7

※同構成の両面板も提供可能です。

* E-0.5/125